

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	财通资管、山西证券、广发证券、信达证券、西部利得、中银资管、泰康资产、华福证券
时间	2026 年 1 月 29 日-2026 年 2 月 3 日
地点	上海、公司和线上
上市公司 接待人员姓名	常务副总经理、董事会秘书：陈小华 合规总监：李珮媛 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题一：公司布局的华东制造基地项目大概什么时候投产？</b></p> <p>答：公司布局的华东制造基地项目将分阶段投产：一期预计 2028 年投产，计划在取得土地使用权后 3 个月内开工（预计 2026 年下半年启动）；二期在一期竣工后 6 个月内启动，预计 2030 年投产；整个项目计划于 2035 年全面达产。公司将根据市场需求动态优化生产策略，确保风险可控和资源高效配置。建成后将新增年产 23,000 吨半导体用光刻胶及配套树脂、电镀液、高纯试剂等核心电子化学品的生产能力，产品广泛应用于晶圆制造与先进封装环节，是支撑我国半导体产业链自主可控的关键布局之一。</p>

**问题二：现有产能可以覆盖到什么时候？**

答：公司现有产能 16,000 吨，主要支撑光刻胶、电镀液等核心产品的规模化供应。在 2028 年华东制造基地一期投产前，现有产能可通过优化生产排程和客户结构，基本覆盖市场需求。随着华东制造基地逐步释放产能，公司将实现新旧产能衔接。此外，为应对过渡期可能的供应压力，公司也在积极评估与中试基地的合作模式，以灵活补充阶段性产能需求，确保客户交付稳定。

**问题三：华东制造基地的投资资金来源？**

答：华东制造基地资金来源主要包括公司自有资金及自筹资金。后续公司将根据项目实施进度，视实际需求灵活采用债权或股权融资等方式，以保障项目建设的顺利推进。

**问题四：项目达产后将大幅扩产，23,000 吨年产能的市场需求是否有明确订单支撑？**

答：公司年产 23,000 吨集成电路材料项目聚焦高端电子化学品国产替代的迫切需求，目标市场空间广阔，公司核心客户产能利用率已进入高位爬升阶段，需求放量在即，为项目提供了健康可持续的营收及利润基础。公司先进封装光刻胶、PSPI 产品全覆盖，晶圆前道工艺先进制程大马士革电镀钴、电镀铜、清洗液等产品已量产，正逐步放量。另外项目所依托的核心技术已完成工艺验证，关键产品在多家重点客户端实现导入并达成性能指标，客户反馈乐观，技术产业化路径清晰，具备规模转化的条件。

**问题五：投资周期长达十年，资本开支较大，未来是否会因折旧增加而影响短期盈利能力？**

答：首先，短期来看折旧会对利润增速形成一定的影响，公司通过分阶段投产策略、高毛利产品布局和政策资源协同，确保资本开支转化为长期价值，而非短期负担。其次，公司已与多家国内头部晶圆厂和先进封装客户建立联合开发机制，部分产品进入认证流程，为 2028 年一期

	投产后的订单承接提供明确保障。另外，项目落地南通经开区，可享受产业等政策支持。最后，目前半导体材料国产化率较低，公司必须抓住国产替代窗口期，通过该项目完成产能和技术卡位，构建国产半导体材料的核心护城河。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 2 月 4 日